

[ニュースリリース一覧に戻る](#)



3M、次世代半導体パッケージングコンソーシアム「JOINT3」に参

当資料は、3M社（本社：米国ミネソタ州、NYSE:MMM）が発表した報道資料を抄訳したものです

3Mは、半導体材料、装置、設計のグローバルリーダーを結集する次世代半導体パッケージングコンソーシアムJOINT3に参加しました。

「JOINT3」は、電子機器の各部分をつなぐ有機材料から作られた薄層であるパネルレベルの有機インターポーラーに最適化されたツールの開発を加速することを目的に、日本のレゾナック株式会社が設立した共創評価プラットフォームです。

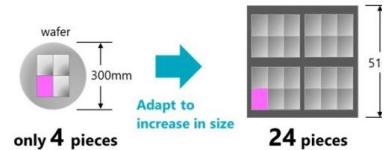
近年、製造された半導体の相互接続、パッケージング、テストを含むバックエンドプロセスにおけるパッケージングの革新は、生成AIや自動運転車などの急速に拡大する市場に不可欠な次世代半導体のキー技術の1つとなっています。の中でも、複数の半導体チップを並列に並べてインターポーラーで接続する2xDパッケージは、データ通信容量や速度要件の増加により、さらなる需要拡大が見込まれています。半導体の性能向上に伴い、インターポーラーのサイズが大きくなり、シリコンから有機材料への移行が促されています。従来、インターポーラーは円形のウェーハから切断されますが、サイズが大きくなるにつれて、ウェーハあたりの生産数は少なくなります。これに対抗するため、円形ウェーハの代わりに正方形のパネルを使用する新しい製造方法が登場し、インターポーラーの歩留まりが向上しています。515 x 510mmのパネルレベルの有機インターポーラーのプロトタイプインを使用して、パネルレベルの有機インターポーラーに最適化された設計に取り組んでいます。

材料科学とイノベーションの世界的リーダーである3Mは、JOINT3共創評価プラットフォームを通じてレゾナックやその他の半導体業界のリーダーと提携し、可能になります。

3Mのディスプレイ&エレクトロニクスプロダクトプラットフォーム部門のプレジデントであるスティーブン・ヴァンダー・ロウ「デバイス性能とシステム革新的なパッケージング技術は、次世代のAIおよび高性能チップの製造に不可欠です」と述べています。「高度な半導体アプリケーションにおいて、ますます短いスケジュールで困難な課題に対する包括的なソリューションを提供する必要があります。3Mは、主要な技術プラットフォームとソリューションを提供して、先端パッケージングの未来を形作り、半導体製造の進歩とロードマップの進歩を促進したいと考えています。」

【3Mについて】

3M（NYSE: MMM）は、サイエンスの力で、革新的かつお客様中心のソリューションを創出し、世界中の産業の変革に注力しています。私たちの多様な専門知識と独自の強み、グローバルな展開、そして卓越した運営力を活かし、お客様の課題解決に取り組んでいます。3Mがどのように未来を築いているかは、3M.com/



報道関係の方のお問い合わせ先

メールでの問い合わせ（[米国](#)）（[日本](#)）

お返事には数日いただく可能性がございます。

こちらは報道関係者向けの連絡先です。報道関係者以外の方は[こちら](#)からお問い合わせください。

更新お知らせの購読

3M Japan News Centerの更新のお知らせを購読する

購読

フォローする



[法務情報](#) | [プライバシーポリシー](#) | [DMCA](#) | [Accessibility Statement](#) | [Cookie Preferences](#) | [Your Privacy Choices](#)

© 3M 2025. All Rights Reserved.